us/kh

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

10/647,343 CAU 2879

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 8月20日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-296258

[ST. 10/C]:

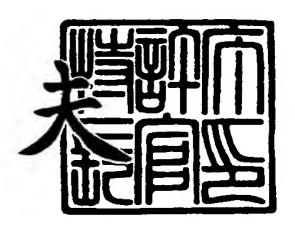
[JP2003-296258]

出 願 人 Applicant(s):

キヤノン株式会社

2003年10月 7日

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 今井康



殿

```
【書類名】
               特許願
【整理番号】
              256248
              平成15年 8月20日
【提出日】
【あて先】
              特許庁長官
【国際特許分類】
              H01J 31/12
【発明者】
   【住所又は居所】
              東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
   【氏名】
               上口 欣也
【特許出願人】
   【識別番号】
              000001007
   【氏名又は名称】
               キヤノン株式会社
【代理人】
   【識別番号】
              100123788
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              宮崎 昭夫
   【電話番号】
              03-3585-1882
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100088328
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              金田
                  暢之
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100106297
   【弁理士】
   【氏名又は名称】
              伊藤
                  克博
【選任した代理人】
   【識別番号】
              100106138
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              石橋 政幸
【先の出願に基づく優先権主張】
   【出願番号】
              特願2002-248839
  【出願日】
              平成14年 8月28日
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】
```

【納付金額】

【提出物件の目録】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【物件名】

【包括委任状番号】

## 【書類名】特許請求の範囲

## 【請求項1】

互いに対向する第1の基板および第2の基板の間に外部よりも圧力の低い空間を有する気 密容器の製造方法であって、

前記空間側になる面に電極が設けられた第1の基板と、前記電極に電位を供給するため の構造体を有する第2の基板とが対向しており、該第1の基板と第2の基板の間に内部空 間を有する容器を組み立てる組み立て工程と、

前記工程で形成された容器の内外に圧力差を与える圧力差印加工程と、

を有しており、前記圧力差印加工程前の前記容器において、前記第2の基板を貫通する貫通孔部で外部雰囲気に対して開口しており且つ底部が閉じた凹部を前記構造体が有しており、前記圧力差印加工程において圧力差を与えることで前記構造体の前記第1の基板と第2の基板の対向方向の長さを伸張させて、前記構造体を該構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状にすることを特徴とする気密容器の製造方法。

#### 【請求項2】

互いに対向する第1の基板および第2の基板の間に外部よりも圧力の低い空間を有する気 密容器の製造方法であって、

前記空間側になる面に電極が設けられた第1の基板と、前記電極に電位を供給するため の構造体を有する第2の基板とが対向しており、該第1の基板と第2の基板の間に内部空 間を有する容器を組み立てる組み立て工程と、

前記工程で形成された容器の内外に圧力差を与える圧力差印加工程と、

を有しており、前記圧力差印加工程前の前記容器において、前記構造体は前記第2の基板に接着されている部分と前記電極と直接的もしくは間接的に接触すべき部分との間に、曲がり形状を有する面を有しており、前記圧力差印加工程において前記曲がり形状を有する面の内側と外側との間に圧力差を与えることで前記面を変形させて、前記構造体を該構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状にすることを特徴とする気密容器の製造方法

# 【請求項3】

前記構造体の前記電極と直接もしくは間接的に接触するべき部分と前記変形する部分とは 一つの板状部材を曲げ加工することで形成された部分である請求項1もしくは2に記載の 気密容器の製造方法。

#### 【請求項4】

前記構造体の前記電極と直接もしくは間接的に接触するべき部分と前記変形する部分と前記第2の基板と接着される部分とは一つの板状部材を曲げ加工することで形成された部分である請求項3に記載の気密容器の製造方法。

# 【請求項5】

内部に画像表示素子を有する気密容器の製造方法として請求項1に記載の気密容器の製造 方法を行うすることを特徴とする画像表示装置の製造方法。

## 【請求項6】

内部に画像表示素子を有する気密容器の製造方法として請求項2に記載の気密容器の製造 方法を行うことを特徴とする画像表示装置の製造方法。

#### 【請求項7】

電極が設けられた第1の基板と、

該第1の基板の前記電極が設けられた面に対向する第2の基板と、

該第2の基板に接着され、前記電極と直接もしくは間接的に接触することによって前記 電極に電位を供給する構造体と、を有しており、

前記構造体は、前記第1の基板と第2の基板との間の内部空間の圧力が外部雰囲気の圧力よりも低いことによって変形している部分と前記電極に直接もしくは間接的に接触する部分とが一つの板状部材を曲げ加工することで形成されたものであることを特徴とする気密容器。

### 【請求項8】

電極が設けられた第1の基板と、

該第1の基板の前記電極が設けられた面に対向する第2の基板と、

該第2の基板に接着され、前記電極と直接もしくは間接的に接触することによって前記電極に電位を供給する構造体と、を有しており、

前記構造体は、前記第2の基板を貫通する貫通孔部で該第2の基板の前記第1の基板に対向する面に接着されており、且つ、前記第1の基板と第2の基板の間に構成される内部空間に対する外部雰囲気に対して前記貫通孔部で開口し且つ底部が閉じた凹部を有しており、且つ、前記第2の基板の前記第1の基板に対向する面に接着されている部分として前記第2の基板に接着されている面の反対側の面が前記外部雰囲気に露出している部分を有するものであることを特徴とする気密容器。

# 【請求項9】

請求項7に記載の気密容器と、該気密容器内に配置された画像表示素子とを有することを特徴とする画像表示装置。

## 【請求項10】

請求項8に記載の気密容器と、該気密容器内に配置された画像表示素子とを有することを特徴とする画像表示装置。

### 【書類名】明細書

【発明の名称】気密容器とその製造方法並びに画像表示装置

## 【技術分野】

## $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、気密容器とそれを用いた画像表示装置に関するものである。また内部が外部よりも低圧力状態に維持される気密容器に関するものである。

## 【背景技術】

## [0002]

近年、画像表示装置として、カラー陰極線管(CRT)が広く用いられているが、駆動原理が陰極からの電子ビームを偏向させ、画面の蛍光体を発光させる方式のため、画面サイズに伴った奥行きが必要であった。画面を大きくするに伴い、奥行きも長くなるため、設置スペースの拡大、重量の増加といった問題から、薄型で軽量化の可能である平面型画像表示装置が強く切望されている。平面型画像表示装置の例として、表面伝導型電子放出型ディスプレイパネル(以後SEDと言う)(特許文献1に記載)、電界放出型表示装置(以後FEDと言う)がある(特許文献2に記載)。

## [0003]

図11に特許文献2に記載される平面型画像表示装置の例の概要図を示す。アノード電極である給電導電層6を擁する前面パネル2、カソード電極7を設けた背面パネル3、絶縁層8、28を挟み込み、封着する。その後、排気管(不図示)からポンプで内部の大気を吸い出し、封止し、真空構造を形成することで超薄型平面表示装置20を作製する。給電導電層6とカソード電極7間に電圧をかけ、カソード電極7から電子が放出する。放出した電子が蛍光面1を発光させ画素を形成し、前面パネル2上に画像を表示する。この時、給電導電層6に電圧を印加するため、背面パネル3に開けた孔部15から、端子導出部17を介し、蛍光面電位給電用端子16、弾性体19、給電導電層6を用いる。そのために、端子導出部を覆う、シール体18の真空封止が必要となっていた。

#### $[0\ 0\ 0\ 4]$

また、特許文献3には画像形成装置に用いる真空容器が開示されており、図16において、真空力で弾性ばね部材を変形させ、高圧導入端子を直接引き出し配線上に接続する構成が開示されている。

【特許文献1】特開平09-045266号公報

【特許文献2】特開平05-114372号公報

【特許文献3】特開2000-195449号公報

## 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### $[0\ 0\ 0\ 5]$

本願発明は、内部に電極を有する気密容器であって、該電極に電位を供給できる構成を容易に実現できる新規な製造方法を実現すること、または、ローコストな気密容器を実現すること、またはローコストな画像表示装置を実現することを課題とする。

### 【課題を解決するための手段】

#### [0006]

本願に係る気密容器の製造方法の一つは以下のように構成される。すなわち、

互いに対向する第1の基板および第2の基板の間に外部よりも圧力の低い空間を有する 気密容器の製造方法であって、

前記空間側になる面に電極が設けられた第1の基板と、前記電極に電位を供給するため の構造体を有する第2の基板とが対向しており、該第1の基板と第2の基板の間に内部空 間を有する容器を組み立てる組み立て工程と、

前記工程で形成された容器の内外に圧力差を与える圧力差印加工程と、

を有しており、前記圧力差印加工程前の前記容器において、前記第2の基板を貫通する貫通孔部で外部雰囲気に対して開口しており且つ底部が閉じた凹部を前記構造体が有しており、前記圧力差印加工程において圧力差を与えることで前記構造体の前記第1の基板と第

2の基板の対向方向の長さを伸張させて、前記構造体を該構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状にすることを特徴とする気密容器の製造方法、である。

## [0007]

この構造体において、前記圧力差によって伸張する部分としては弾性を有するように構成することもでき、弾性を有することで圧力差印加工程後に第1基板と第2基板の間隔が一時的もしくは恒久的に狭くなることを許容しやすくなる。ただしそれに限るものではなく、前記圧力差によって塑性変形して伸張するようにしてもよい。

### [0008]

また、前記組み立て工程は適宜実施することができるが、一例としては前記組み立て工程が、前記電極が形成された第1の基板を準備する工程と、前記構造体が設けられた第2の基板を準備する工程と、第1の基板と第2の基板とを対向して配置して接着を行う工程とを有する構成を好適に採用できる。また第1の基板と第2の基板との間に第1の基板と第2の基板の間隔を維持する部材を配置してもよい。該部材としては内部空間を取り囲むように配置される枠や、外周を規定された内部空間内の適宜位置に設けられるスペーサを挙げることができる。

# [0009]

また、構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状とは、外部の電位供給回路などと接続して構造体に電位を供給すれば構造体を介して前記電極に電位の供給が行われる形状のことをいう。構造体に電位を供給しながら圧力差印加工程を行っている場合には、構造体の形状が、構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状になった時点で電位の供給が行われることになる。

# [0010]

また、圧力差印加工程としては、組み立て工程で排気管等の通気部を通じて内部を減圧できるように容器を組み立てておき、該組み立ての後、通気部から内部のガスを抜き出して圧力差を印加する工程や、減圧雰囲気で組み立て工程を行って気密容器を構成しておき、その後、より高い圧力の雰囲気に該容器を晒すことで圧力差を印加する工程を好適に採用することができる。

### $[0\ 0\ 1\ 1]$

他の発明の一つは以下のように構成される。すなわち、

互いに対向する第1の基板および第2の基板の間に外部よりも圧力の低い空間を有する 気密容器の製造方法であって、

前記空間側になる面に電極が設けられた第1の基板と、前記電極に電位を供給するため の構造体を有する第2の基板とが対向しており、該第1の基板と第2の基板の間に内部空 間を有する容器を組み立てる組み立て工程と、

前記工程で形成された容器の内外に圧力差を与える圧力差印加工程と、

を有しており、前記圧力差印加工程前の前記容器において、前記構造体は前記第2の基板に接着されている部分と前記電極と直接的もしくは間接的に接触すべき部分との間に、曲がり形状を有する面を有しており、前記圧力差印加工程において前記曲がり形状を有する面の内側と外側との間に圧力差を与えることで前記面を変形させて、前記構造体を該構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状にすることを特徴とする気密容器の製造方法、である。

## $[0\ 0\ 1\ 2]$

この曲がり形状は曲がっていなかった形状のものをプレス加工などの曲げ加工することによって形成することができるが、曲がっていなかった形状の固体部材を曲げ加工して作った形状には限らない。例えば鋳造によって曲がり形状を有する構造体を製造してもよい。また曲がり形状を有する面は曲面や折れ曲がった形状を有する面を含む。折れ曲がった形状とは折れ曲がっていなかった形状に対して折り曲げ加工して形成した形状に限るものではなく、例えば複数の部材を接合して折れ曲がった形状を実現したものを含む。曲がり形状の一つとして蛇腹状の形状を挙げることができるが、この形状は曲げ加工としてプレス加工を用いて形成することもできるし、リング状の複数の部材の内径端と外径端とを交

互に接合することによっても形成することができる。

## [0013]

ただし、前記構造体の前記電極と直接もしくは間接的に接触するべき部分と前記変形する部分は一つの板状部材を曲げ加工することで形成すると好適であり、曲げ加工としてプレス加工を用いるのが特に好適である。更に好ましくは前記構造体の前記電極と直接もしくは間接的に接触するべき部分と前記変形する部分と前記第2の基板と接着される部分を一つの板状部材を曲げ加工することで形成するのが望ましい。

## [0014]

また第1基板に設けられた電極に電位を供給する構造体の全部もしくは電位供給経路となる部分は導体で構成するとよい。導体としては金属(合金を含む)を好適に用いることができる。上記のように複数の部分を一つの板状部材を加工して形成する場合には、該板状部材としては金属板を用いるとよい。

### $[0\ 0\ 1\ 5]$

本願に係る気密容器の製造方法は、気密容器を有する画像表示装置の製造に好適に適用することができる。

#### $[0\ 0\ 1\ 6]$

具体的に言うと、第1の基板もしくは第2の基板のいずれかもしくは両方の前記内部空間側になるべき位置に予め画像表示素子もしくはその画像形成素子を構成するための電極を形成しておいてから、前記気密容器の製造方法を実施するとよい。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

また本願は気密容器の発明として以下の構成の発明を含んでいる。すなわち、

電極が設けられた第1の基板と、

該第1の基板の前記電極が設けられた面に対向する第2の基板と、

該第2の基板に接着され、前記電極と直接もしくは間接的に接触することによって前記電極に電位を供給する構造体と、を有しており、

前記構造体は、前記第1の基板と第2の基板との間の内部空間の圧力が外部雰囲気の圧力よりも低いことによって変形している部分と前記電極に直接もしくは間接的に接触する部分とが一つの板状部材を曲げ加工することで形成されたものであることを特徴とする気密容器、である。

## [0018]

構造体の第2の基板への接着は直接基板に接着するものであっても、間接的に接着する ものであってもよい。

#### $[0\ 0\ 1\ 9]$

また、前記構造体は、前記電極と直接接触していてもよく、また前記電極よりも柔軟な金属(合金を含む)を介して間接的に接触していてもよく、また、導電性の接着材を介して接着されていてもよい。該接着としては溶融した金属が固化したものが接着材として前記構造体と前記電極とを接着している構成を好適に採用できる。

#### [0020]

また気密容器の他の発明として以下の構成のものを含んでいる。すなわち、

電極が設けられた第1の基板と、

該第1の基板の前記電極が設けられた面に対向する第2の基板と、

該第2の基板に接着され、前記電極と直接もしくは間接的に接触することによって前記電極に電位を供給する構造体と、を有しており、

前記構造体は、前記第2の基板を貫通する貫通孔部で該第2の基板の前記第1の基板に対向する面に接着されており、且つ、前記第1の基板と第2の基板の間に構成される内部空間に対する外部雰囲気に対して前記貫通孔部で開口し且つ底部が閉じた凹部を有しており、且つ、前記第2の基板の前記第1の基板に対向する面に接着されている部分として前記第2の基板に接着されている面の反対側の面が前記外部雰囲気に露出している部分を有するものであることを特徴とする気密容器、である。

#### [0021]

また画像表示装置の発明として、本願に係る気密容器と、該気密容器内に配置された画像表示素子とを有する画像表示装置の発明を本願は含んでいる。

## [0022]

画像表示素子としては例えば電子放出素子を好適に採用することができる。画像表示素子として電子放出素子を用いる場合には、該電子放出素子が放出する電子によって発光する発光体を更に配置するとよい。一例としては、電子放出素子を第1基板と第2基板の一方に設け、発光体を他方の基板に配置する構成を好適に採用できる。電子放出素子を用いる場合には、放出した電子を加速するための加速電位が供給される電極を内部に配置する構成を好適に採用することができ、本願発明における第1の基板に設けられる電極としてはこの加速電位が供給される電極、もしくは該電極から引き出された引出し電極を挙げることができる。この場合前記構造体はこの加速電位を前記電極に供給するために配置されているとよい。なお画像表示素子としてはこの構成のものに限らずエレクトロルミネセンス素子やプラズマディスプレイを構成するためのプラズマセルなどを採用することもできる。

## 【発明の効果】

#### [0023]

本願発明によって、好適に気密容器及び画像表示装置を実現することができる。

# 【発明を実施するための最良の形態】

## [0024]

本発明の一実施形態の概要図を図1および図2に示す。平面上にアノード104を備え たフェイスプレート101と、平面上にカソード1001を備えたリアプレート102を 向かい合わせ、間に枠103とスペーサ1002を挟み込んで、接着する事によって気密 容器106を作製することができる。カソード1001は画像表示素子である電子放出素 子であり、この電子放出素子が放出する電子は加速電極であるアノードに印加される加速 電位によって加速される。この気密容器は、内部が10<sup>-4</sup>Pa以下に保たれ真空容器とさ れる(以下、この気密容器を真空容器という)。この真空容器内にカソードを保持するこ とでカソードを電子源として機能させることができる。真空容器には、真空容器内のカソ ードから引出し配線(不図示)がリアプレート102上に設置してあり、枠103の外部 まで伸びている。カソードは、その引出し配線終端で電気的に導通されている引出しケー ブル110を介して駆動装置150により制御されている。また、アノードは、後に詳述 する本願発明に係る構造体を含む電圧印加構造100およびこの電圧印加構造にコネクタ (不図示)にて取り付けた電圧印加ケーブル161を介して、電圧印加装置160により 制御されている。電圧印加装置160から供給される電位が構造体に供給され、構造体を 介して加速電極であるアノードに供給される。そして、真空容器106内のカソードとア ノードに、これらの制御を行う事で画像表示装置105に画像を形成することができる。 フェイスプレート101とリアプレート102は、それぞれ本願発明の第1基板と第2基 板を構成するものであり、例えばガラス製とすることができる。画像表示装置105の真 空容器の内部は外部雰囲気よりも圧力が低くなっており、すなわち、真空である。フェイ スプレート101とリアプレート102と枠103とを、フリットガラスなどで接着する ことで、フェイスプレート101とリアプレート102間の気密が保たれるようになって いる。画像表示装置105は、アノード104に電圧を印加することにより、リアプレー ト102上のカソード1001から真空中に出た電子が加速され、アノード104にある 蛍光体(不図示)に衝突し発光させることによって画像を形成することが出来る。

#### [0025]

大気中から内部が真空となっている画像表示装置105内への給電機構として、電圧印加構造100がある。画像表示装置105は、フェイスプレート101、リアプレート102、枠103を接着し、電圧印加構造100を備えた既出の真空容器と、引出しケーブル110、駆動装置150、電圧印加ケーブル161、電圧印加装置160から構成される。図3に図1のA-A部分断面図を示す。電圧は、リアプレート102の裏面から貫通孔(以下、穴という)111を通して導電性部材108に印加され、低融点材料107を

5/



介しアノード104に印加される。穴は直径約2mmである。

## [0026]

本願発明の構造体は、導電性部材108から構成されており、導電性部材108は圧力差によって伸張する部分として特に曲がり形状を有する部分である蛇腹部分とアノードに接触する部分と、リアプレートに接着される部分とを有している。電圧印加構造100は、導電性部材108、低融点材料107、接合部材109から構成されている。

## [0027]

導電性部材108はアノード104に直接接触させることもできるが、これらの間に低融点材料107を介在させることが好ましい。低融点材料は、導電性部材108とアノード104の密着性を良くすることで、導電性を良くする部材として用いている。低融点材料は、大気圧により変形する導電性部材108とアノード104との間で圧縮変形し、導電性部材108とアノード104の表面形状に密着し、電気的導通信頼性を良好にする事が出来る。この時、低融点材料107として、目安として製品使用温度である100℃以上の固相線温度を持ち、この真空容器が作製される温度420℃以下の融点を持った、かつ導電性のある材料から適宜選択することができ、例えば低融点の金属材料を使用することができる。導電性部材108とアノードとの電気的接続性を向上させる部材として低融点金属を用いているが、この部材としてはアノードよりも柔らかい部材を用いると好適である。この部材を接着材として導電性部材108とアノード104とが接着されるようにしてもよい。

# [0028]

画像表示装置105が周囲の予想外の温度の影響を受けて熱膨張により変形したとき、 導電性部材108とアノード104の密着性が悪くなる場合がある。このとき、導電性部 材108へ高周波電圧を印加し、発熱させて低融点材料107を溶融する事によって、画 像表示装置105を解体せずに導電性部材108とアノード104の密着性を改善する事 が出来る。溶融した低融点材料は温度が下がることで固化して導電性部材108とアノー ド104とを接合する部材となる。

#### [0029]

導電性部材108とリアプレート102の接合に接合部材109を使用して真空気密を確保している。接合部材109の材質としては、例えば、低融点ガラスであるフリットを使用している。あらかじめフリットと溶媒を混合したものをディスペンサーにて導電性部材108に塗布し、乾燥(例えば、120℃、10分)、仮焼成(例えば、360℃、10分)を行う。その後、本焼成工程(例えば、420℃、30分)において、導電性部材108はリアプレート102上に置かれ、昇温しながら仮焼成したフリットを潰すように導電性部材108に荷重を加えることで、良好な接合が得られる。

#### [0030]

導電性部材108は、リアプレートと接合される部分である接着部と伸長部と低融点金属を介してアノードと接触する接触部からなる一体部品である。その材質は、作製時の熱応力を緩和するため、リアプレート102に使用する材料の熱膨張と略一致する熱膨張係数のものを選ぶと良い。例えばリアプレートに熱膨張係数8.0×10 $^{-6}/\mathbb{C}\sim9$ .0×10 $^{-6}/\mathbb{C}$ のガラスを用いる場合、導電性部材の熱膨張係数は7.5×10 $^{-6}\sim1$ .0×10 $^{-5}/\mathbb{C}$ であることが好ましい。導電性部材108は、接合部材109によって、リアプレート102に接合されている。導電性部材108とリアプレート102の間の1箇所のみが電圧印加構造100の接合部であるため、接合不良によるリークや強度低下の確率を抑える事が出来る。この導電性部材108は、例えば、導電性材料からなる板を空気により型に吸引し、プレス成形することで作製することができる。

### [0031]

リアプレート102に設置された状態における導電性部材のリアプレート102上面からの高さは、リアプレート102とフェイスプレート101間のギャップより短く作製することができる。図4(A)に示すように、導電性部材108は、接合部材109によってリアプレート102と接合されている。その後図4(B)のように、リアプレート10



2とフェイスプレート101とで枠を挟みこみ、リアプレートと枠との間および枠とフェイスプレートとの間がフリット等により封着される。そして、不図示の排気管からリアプレート102とフェイスプレート101間を真空に引き、封止することで、画像表示装置の真空容器を作製する。その時図4(C)のように、導電性部材108はリアプレートの貫通孔である穴111において外部雰囲気に開口する凹部であって、底部すなわちアノード側が閉じた凹部を有する形状になっているため、穴111からの大気圧と内部空間の圧力との圧力差の影響をうけてリアプレート102とフェイスプレート101間のギャップ長さまで伸長し、アノード104と低融点材料107を介して間接的に接触することで、導電性部材108を介してリアプレート側からフェイスプレート101に形成された電極であるアノードに電位を供給できる形状を実現することができる。この状態で導電性部材108に電位を供給すると導電性部材108を介してアノードに電位が供給される。

## [0032]

本願発明の構造体を構成する導電性部材として、アノードに接触する部分と伸張する部分とリアプレートに接着される部分とを1つの板状部材の形状を変形させて形成することで、穴111封止の封止接合界面を1箇所に出来、接合不良やリークの確率を抑える事ができる。これにより、真空容器106および画像表示装置105の歩留まりを向上する事が出来、より安価な画像表示装置105を提供する事ができる。また圧力差が印加される前の構造体を穴111の部分で外部雰囲気に開口する凹部であって、底部すなわちアノード側が閉じた凹部を有する形状とすることによって、凹部の側部を伸張する部分として用いることができるようになり、伸張できる長さを十分にとることができるようになる。また、圧力差が印加される前の伸張予定部分として曲がり形状を有する構造体を採用することで伸長できる長さを十分に取ることが可能となる。

## 【実施例】

## [0033]

#### (実施例1)

図3に示す形態の電圧印加構造、この電圧印加構造を備える図1および図2に示す形態の真空容器を有する図1に示す形態の画像表示装置を作成した。

#### [0034]

平面上にアノード104を備えたフェイスプレート101と、平面上にカソード100 1を備えたリアプレート102を向かい合わせ、間に枠103とスペーサ1002を挟み 込んで、接着する事によって真空容器106を作製した。この真空容器には、真空容器内 のカソードから引出し配線(不図示)がリアプレート102上に設置してあり、枠103 の外部まで伸びている。カソードは、その引出し配線終端で電気的に導通されている引出 しケーブル110を介して駆動装置150により制御されている。また、アノードは電圧 印加構造100にコネクタ(不図示)にて取り付けた電圧印加ケーブル161を介して、 電圧印加装置160により制御されている。そして、真空容器106内のカソードとアノ ードに、これらの制御を行う事を可能として画像表示装置105を構成している。フェイ スプレート101とリアプレート102は、厚さ2.8mmのガラスで出来ている。画像 表示装置105の内部は真空であり、フェイスプレート101とリアプレート102と枠 103との接着にはフリット(不図示)を使用する。枠103にフリットを溶媒で粘土状 にしたフリットペーストを塗布した後、乾燥させ、加圧しながらオーブンにて420℃、 30分焼成して接着する。このように接着することで、フェイスプレート101とリアプ レート102間の気密を保っている。画像表示装置105は、アノード104に電圧を印 加することにより、リアプレート102上のカソードから真空中に出た電子が加速され、 アノードにある蛍光体(不図示)に衝突し発光させることによって画像を形成することが 出来る。

### [0035]

真空容器106は、大気中からの内部が真空となっている画像表示装置105内への給電機構として、電圧印加構造100を有する。図3に図1のA-A部分断面図を示す。電圧は、リアプレート102の裏面から穴111を通して導電性部材108に印加され、低



融点材料107を介しアノード104に印加される。

## [0036]

電圧印加構造100は、前記した導電性部材108、低融点材料107、接合部材109から構成されている。リアプレートに開いている穴111は直径2mmである。

## [0037]

導電性部材 108とアノード 104 の間に低融点材料 107を介在させている。これは、導電性部材 108とアノード 104 の密着性を良くすることで、導電性を良くする役割のものである。低融点材料として、低融点の金属材料の 1n 合金(融点 140 -200  $^{\circ}$  )を使用した。大気圧により変形した(伸張した)導電性部材 108とアノード 104 との間で低融点材料が圧縮変形し、導電性部材 108とアノード 104 の表面形状に密着し(図 104 (C))、電気的導通信頼性を良好にする事が出来る。

## [0038]

さらには、画像表示装置105が周囲の予想外の温度の影響を受けて熱膨張により変形したとき、導電性部材108とアノード104の密着性が悪くなる場合がある。このとき、導電性部材108へ高周波電圧を印加し、発熱させて低融点材料107を溶融する事によって、画像表示装置105を解体せずに導電性部材108とアノード104の密着性を改善する事が出来る。

### [0039]

導電性部材108とリアプレート102の接合に接合部材109を使用して真空気密を確保している。接合部材109の材質としては、低融点ガラスであるフリットを使用している。あらかじめフリットと溶媒を混合したものをディスペンサーにて導電性部材108に塗布し、乾燥(120  $\mathbb C$ 、10  $\mathbb C$ )、仮焼成(360  $\mathbb C$  、10  $\mathbb C$ )を行った。その後、本焼成工程(420  $\mathbb C$  、30  $\mathbb C$ )において、導電性部材108 はリアプレート102 上に置かれ、昇温しながら仮焼成したフリットを潰すように導電性部材108 に荷重を加えることで、良好な接合が得られた。

## [0040]

導電性部材108は、直径4 mmの接着部と伸長部からなる一体部品である。材質は42 N i-6 C r-F e 合金(熱膨張係数 $8.5 \times 10^{-6}/\mathbb{C} \sim 9.8 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )であり、リアプレート102 に使用するガラス(熱膨張係数 $8.0 \times 10^{-6}/\mathbb{C} \sim 9.0 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )の熱膨張と略一致させていることで、作製時の熱応力を緩和している。導電性部材108 は、接合部材109 によって、リアプレート102 に接合されている。導電性部材108 とリアプレート102 の間の1 箇所のみを電圧印加構造100 の接合部にできたことにより、接合不良によるリークや強度低下の確率を抑える事が出来た。

#### $[0\ 0\ 4\ 1]$

この導電性部材 108 は、直径約 10 mm、厚さ 0.05 mmの板を空気により型に吸引し、プレス成形することで作製した。形状は、アノード 104 側から画像表示装置 105 を見たときに、外直径約 4 mmの円形状であり、高さは約 0.7 mmであり、リアプレート 102 とフェイスプレート 101 間のギャップ長さ 2 mmより短く作製した。この導電性部材 108 を、図 4 (A) に示すように、接合部材 109 によってリアプレート 102 とフェイスプレート 102 とフェイスプレート 102 とで枠 103 を挟みこみ、フリットにてリアプレート 102 とフェイスプレート 103 を挟みこみ、フリットにてリアプレートと枠との間および枠とフェイスプレート 103 を可能を封着した。そして、不図示の排気管からリアプレート 102 とフェイスプレート 101 間を真空に引き、封止することで、真空容器を作製した。その時図 104 との上 104 との正力差によってリアプレート 104 との正力差によってリアプレート 104 との正力差によってリアプレート 104 との形状がアノード 104 と低融点材料 1040 を介して接触する形状に変形された。

## [0042]

導電性部材108において、プレス成形により加工することで側面の伸縮部に凹凸形状を複数段作る事によって、導電性部材108の大気圧による変形方向をアノード104の





方向に制御することが可能となった。その結果、導電性部材108とアノード104の導 通信頼性を向上することが出来た。

### $[0\ 0\ 4\ 3]$

(実施例2)

本実施例で作成した真空容器及び画像表示装置の概要は、実施例1と同様であるが、電 圧印加構造を図5に示すものに替えた。

#### $[0\ 0\ 4\ 4]$

大気中からの内部が真空となっている画像表示装置105内への給電機構として、電圧 印加構造100がある。図5に実施例2における、図1のA-A部分に相当する断面図を 示す。電圧は、リアプレート102の裏面から穴111を通して導電性部材208に印加 され、低融点材料107を介しアノード104に印加される。

## [0045]

電圧印加構造100は、前記した導電性部材208、低融点材料107、接合部材10 9から構成されている。リアプレートに開いている穴111は直径2mmである。

#### $[0\ 0\ 4\ 6]$

導電性部材208とアノード104の間に低融点材料107を介在させている。これは 、導電性部材208とアノード104の密着性を良くすることで、導電性を良くする役割 のものである。低融点材料として、低融点の金属材料のSn-Pb系ハンダ(融点180 ~330℃)を使用した。大気圧により変形した導電性部材208とアノード104との 間で低融点材料が圧縮変形し、導電性部材208とアノード104の表面形状に密着し、 電気的導通信頼性を良好にする事が出来る。

## [0047]

さらには、画像表示装置105が周囲の予想外の温度の影響を受けて熱膨張により変形 したとき、導電性部材208とアノード104の密着性が悪くなる場合がある。このとき 、導電性部材208へ高周波電圧を印加し、発熱させて低融点材料107を溶融する事に よって、画像表示装置105を解体せずに導電性部材208とアノード104の密着性を 改善する事が出来る。

### [0048]

導電性部材208とリアプレート102の接合に接合部材109を使用して真空気密を 確保している。接合部材109の材質としては、低融点ガラスであるフリットを使用して いる。あらかじめフリットと溶媒を混合したものをディスペンサーにて導電性部材208 に塗布し、乾燥(120℃、10分)、仮焼成(360℃、10分)を行った。その後、 本焼成工程(420℃、30分)において、導電性部材208はリアプレート102上に 置かれ、昇温しながら仮焼成したフリットを潰すように導電性部材208に荷重を加える ことで、良好な接合が得られる。

#### [0049]

導電性部材208は、直径4mmの接着部と伸長部からなる一体部品である。材質は4 7%Ni-Fe合金(熱膨張係数7.5×10<sup>-6</sup>/℃~9×10<sup>-6</sup>/℃)であり、リアプ レート102に使用するガラス(熱膨張係数8.0×10 $^{-6}$ / $\mathbb{C}$ ~9.0×10 $^{-6}$ / $\mathbb{C}$ ) の熱膨張と略一致させていることで、作製時の熱応力を緩和している。導電性部材208 は、接合部材109によって、リアプレート102に接合されている。導電性部材208 とリアプレート102の間の1箇所のみを電圧印加構造100の接合部にできたことによ り、接合不良によるリークや強度低下の確率を抑える事が出来た。

### [0050]

この導電性部材208は、直径10mm、厚さ0.05mmの板を空気により型に吸引 し、プレス成形することで作製した。形状は、アノード104側から画像表示装置105 を見たときに、外直径約4mmの円形状であり、高さは約0.7mmであり、リアプレー ト102とフェイスプレート101間のギャップ長さ2mmより短く作製した。この導電 性部材208を、図6(A)に示すように、接合部材109によってリアプレート102 と接合した。その後図6(B)のように、リアプレート102とフェイスプレート101



とで枠103を挟みこみ、フリットにてリアプレートと枠との間および枠とフェイスプレートとの間を封着した。そして、不図示の排気管からリアプレート102とフェイスプレート101間を真空に引き、封止することで、真空容器を作製した。その時図6(C)のように、導電性部材208は穴111からの大気圧の影響をうけてリアプレート102とフェイスプレート101間のギャップ長さ2mmまで伸長する。これによりアノード104と低融点材料107を介して導通させることができる形状を実現できる。

#### $[0\ 0\ 5\ 1]$

導電性部材208において、プレス成形により加工することで側面の伸縮部に凹凸形状を手間をかけずに複数段作る事が出来き、導電性部材208の大気圧による変形方向をアノード104の方向制御することが可能となった。その結果、導電性部材208のリアプレード104の導通信頼性を向上することが出来た。また、導電性部材208のリアプレート102との接着部分として、リアプレート102と接合部材109によって接着される面と反対側の面が外部雰囲気である大気圧雰囲気に露出している構成を採用し、導電性部材208のリアプレート102との接着部分が大気圧によって接着対象側であるリアプレート102側に押し付けられる構造を採用したため、接着面の真空気密性を向上する事が出来た。

## [0052]

(実施例3)

本実施例で作成した真空容器及び画像表示装置の概要は、実施例1と同様であるが、電 圧印加構造を図7に示すものに替えた。

## [0053]

大気中からの内部が真空となっている画像表示装置105内への給電機構として、電圧印加構造100がある。図7に実施例3における、図1のA-A部分に相当する断面図を示す。電圧は、リアプレート102の裏面から穴111を通して導電性部材308に印加され、低融点材料107を介しアノード104に印加される。

#### [0054]

電圧印加構造100は、前記した導電性部材308、低融点材料107、接合部材109から構成されている。リアプレートに開いている穴111は直径2mmである。

## [0055]

導電性部材308とアノード104の間に低融点材料107を介在させている。これは、導電性部材308とアノード104の密着性を良くすることで、導電性を良くする役割のものである。低融点材料として、低融点の金属材料のSn-Cu合金(融点200~350°C)を使用した。大気圧により変形した導電性部材308とアノード104との間で低融点材料が圧縮変形し、導電性部材308とアノード104の表面形状に密着し、電気的導通信頼性を良好にする事が出来る。

#### [0056]

さらには、画像表示装置105が周囲の予想外の温度の影響を受けて熱膨張により変形したとき、導電性部材308とアノード104の密着性が悪くなる場合がある。このとき、導電性部材308へ高周波電圧を印加し、発熱させて低融点材料107を溶融する事によって、画像表示装置105を解体せずに導電性部材308とアノード104の密着性を改善する事が出来る。

### [0057]

導電性部材308とリアプレート102の接合に接合部材109を使用して真空気密を確保している。接合部材109の材質としては、低融点ガラスであるフリットを使用している。あらかじめフリットと溶媒を混合したものをディスペンサーにて導電性部材308に塗布し、乾燥(120 $\mathbb C$ 、10分)、仮焼成(360 $\mathbb C$ 、10分)を行った。その後、本焼成工程(420 $\mathbb C$ 、30分)において、導電性部材308はリアプレート102上に置かれ、昇温しながら仮焼成したフリットを潰すように導電性部材308に荷重を加えることで、良好な接合が得られる。

## [0058]



導電性部材 308 は、直径 4 mmの接着部と伸長部からなる一体部品である。材質は 48% N i - F e 合金(熱膨張係数  $8\times 10^{-6}/\mathbb{C}\sim 9.5\times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )であり、リアプレート 102 に使用するガラス(熱膨張係数  $8.0\times 10^{-6}/\mathbb{C}\sim 9.0\times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )の熱膨張と略一致させていることで、作製時の熱応力を緩和している。導電性部材 308 は、接合部材 109 によって、リアプレート 102 に接合されている。導電性部材 308 とリアプレート 102 の間の 1 箇所のみを電圧印加構造 100 の接合部にできたことにより、接合不良によるリークや強度低下の確率を抑える事が出来た。

## [0059]

この導電性部材308は、直径約9mm、厚さ0.05mmの板を空気により型に吸引し、プレス成形することで作製した。形状は、アノード104側から画像表示装置105を見たときに、外直径約4mm、先端直径0.5mmの円形状であり、高さは約1.5mmであり、リアプレート102とフェイスプレート101間のギャップ長さ2mmより短く作製した。この導電性部材308を、図8(A)に示すように、接合部材109によってリアプレート102と接合した。その後図8(B)のように、リアプレート102とフェイスプレート101とで枠103を挟みこみ、フリットにてリアプレートと枠との間および枠とフェイスプレートとの間を封着した。そして、不図示の排気管からリアプレート102とフェイスプレート101間を真空に引き、封止することで、真空容器を作製した。その時図8(C)のように、導電性部材308は穴111からの大気圧の影響をうけてリアプレート102とフェイスプレート101間のギャップ長さ2mmまで伸長する。これによりアノード104と低融点材料107を介して接触する形状を実現できる。

#### [0060]

導電性部材308によるアノード104との間の低融点材料107の潰し面積を小さくした事から、大気圧による単位あたりの低融点材料107にかかる圧力が増加する事ができた。その結果、導電性部材308とアノード104間の導通信頼性を向上する事ができた。

## [0061]

(実施例4)

本実施例で作成した真空容器及び画像表示装置の概要は、実施例1と同様であるが、電 圧印加構造を図9に示すものに替えた。

### [0062]

大気中からの内部が真空となっている画像表示装置105内への給電機構として、電圧印加構造100がある。図9に実施例2における、図1のA-A部分に相当する断面図を示す。電圧は、リアプレート102の裏面から穴111を通して導電性部材408に印加され、低融点材料107を介しアノード104に印加される。

#### $[0\ 0\ 6\ 3]$

電圧印加構造100は、前記した導電性部材408、低融点材料107、接合部材109から構成されている。リアプレートに開いている穴111は直径2mmである。

#### $[0\ 0\ 6\ 4\ ]$

導電性部材 408とアノード 104 の間に低融点材料 107を介在させている。これは、導電性部材 408とアノード 104 の密着性を良くすることで、導電性を良くする役割のものである。低融点材料として、低融点の金属材料のSn-Ag合金(融点 200-350℃)を使用しており、大気圧により変形した導電性部材 408とアノード 1040の表面形状に密着し、電気的導通信頼性を良好にする事が出来る。

# [0065]

さらには、画像表示装置105が周囲の予想外の温度の影響を受けて熱膨張により変形したとき、導電性部材408とアノード104の密着性が悪くなる場合がある。このとき、導電性部材408へ高周波電圧を印加し、発熱させて低融点材料107を溶融する事によって、画像表示装置105を解体せずに導電性部材408とアノード104の密着性を改善する事が出来る。

## [0066]

導電性部材 408とリアプレート 102の接合に接合部材 109を使用して真空気密を確保している。接合部材 109の材質としては、低融点ガラスであるフリットを使用している。あらかじめフリットと溶媒を混合したものをディスペンサーにて導電性部材 408に塗布し、乾燥(120  $\mathbb C$ 、10  $\mathbb C$ )、仮焼成(360  $\mathbb C$ 、10  $\mathbb C$ )を行った。その後、本焼成工程(420  $\mathbb C$ 、30  $\mathbb C$ )において、導電性部材 408 はリアプレート 102 上に置かれ、昇温しながら仮焼成したフリットを潰すように導電性部材 408 に荷重を加えることで、良好な接合が得られる。

## [0067]

導電性部材 408 は、直径 4 mmの接着部と伸長部からなる一体部品である。材質はFe-Ni-Co合金(熱膨張係数  $7.5 \times 10^{-6}/\mathbb{C} \sim 9.8 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )であり、リアプレート 102 に使用するガラス(熱膨張係数  $8.0 \times 10^{-6}/\mathbb{C} \sim 9.0 \times 10^{-6}/\mathbb{C}$ )の熱膨張と略一致させていることで、作製時の熱応力を緩和している。導電性部材 408 は、接合部材 109 によって、リアプレート 102 に接合されている。導電性部材 408 とリアプレート 102 の間の 1 箇所のみを電圧印加構造 100 の接合部にできたことにより、接合不良によるリークや強度低下の確率を抑える事が出来た。

## [0068]

この導電性部材 408は、直径約 10 mm、厚さ 0.1 mmの板を空気により型に吸引し、プレス成形することで作製した。形状は、アノード 104 側から画像表示装置 105 を見たときに、外直径約 4 mmの円形状であり、高さは約 0.6 mmであり、リアプレート 102 とフェイスプレート 101 間のギャップ長さ 2 mmより短く作製した。この導電性部材 408 を、図 10 (A) に示すように、接合部材 109 によってリアプレート 102 と接合した。その後図 10 (B) のように、リアプレート 102 とフェイスプレート 101 とで枠 103 を挟みこみ、フリットにてリアプレートと枠との間および枠とフェイスプレートとの間を封着した。そして、不図示の排気管からリアプレート 102 とフェイスプレート 101 間を真空に引き、封止することで、真空容器を作製した。その時図 10 (C) のように、導電性部材 108 は穴 111 からの大気圧の影響をうけてリアプレート 102 とフェイスプレート 101 間のギャップ長さ 104 と低融点材料 107 を介して接触する形状を実現できる。

#### [0069]

導電性部材408をリアプレート102の面内方向において円形状にしたため、円に均一な大気圧が発生し、導電性部材408の変形方向をアノード104の方向に制御することが可能となった。その結果、導電性部材408とアノード104の導通信頼性を向上することが出来た。また、導電性部材408とリアプレート102の接合部材109による接着面が、大気圧によって押し付けられる構造を採用したため、接着面の真空気密性を向上する事が出来た。

## 【図面の簡単な説明】

#### [0070]

- 【図1】画像表示装置の一形態を示す模式的平面図である。
- 【図2】本発明の真空容器の一形態を示す模式的部分断面図である。
- 【図3】電圧印加構造の一例を示す模式的部分断面図である。
- 【図4】図3に示す電圧印加構造の製造方法を示す工程図である。
- 【図5】実施例2の電圧印加構造を示す模式的部分断面図である。
- 【図6】実施例2の電圧印加構造の製造方法を示す工程図である。
- 【図7】実施例3の電圧印加構造を示す模式的部分断面図である。
- 【図8】実施例3の電圧印加構造の製造方法を示す工程図である。
- 【図9】実施例4の電圧印加構造を示す模式的部分断面図である。
- 【図10】実施例4の電圧印加構造の製造方法を示す工程図である。
- 【図11】従来の画像表示装置を示す模式図である。

## 【符号の説明】

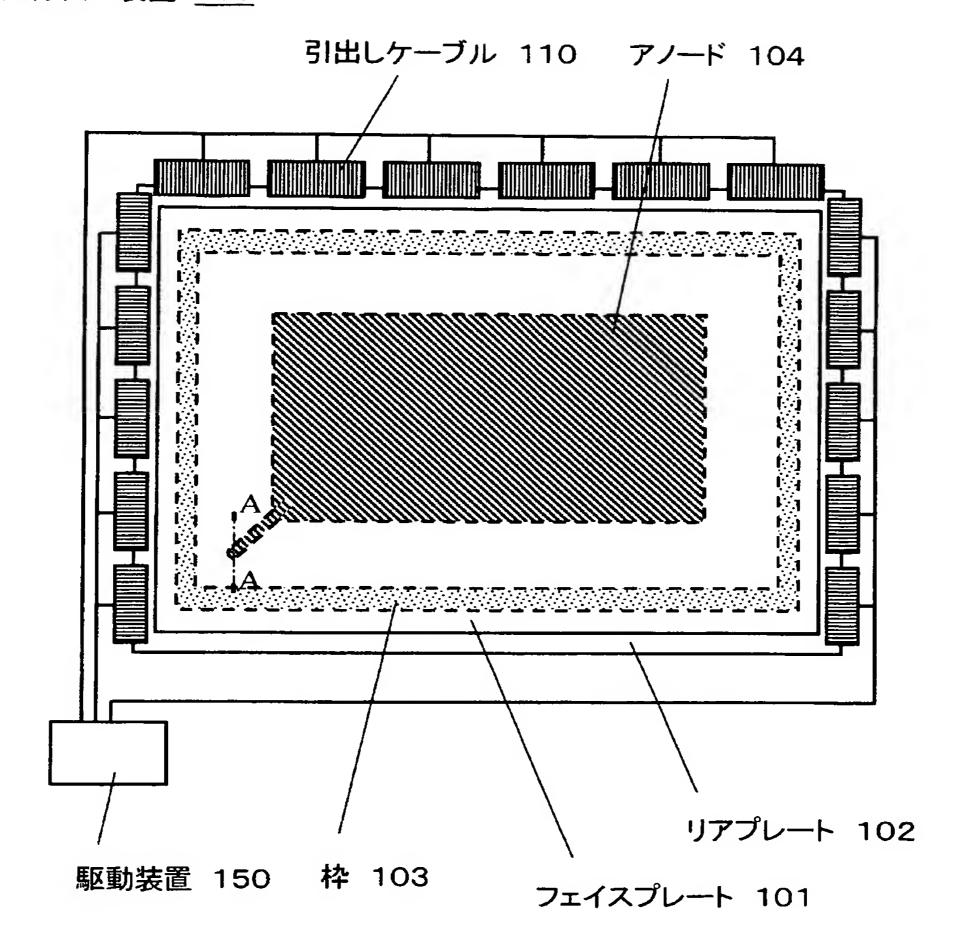


# [0071]

- 1 蛍光面
- 2 前面パネル
- 3 背面パネル
- 6 a メタルバック層
- 6 給電導電層
- 7 カソード電極
- 8 絶縁層
- 15 孔部
- 16 蛍光面電位給電用端子
- 17 端子導出部
- 18 シール体
- 19 弹性体
- 20 超薄型平面表示装置
- 21 フリットガラス
- 28 絶縁層
- 100 電圧印加構造
- 101 フェイスプレート
- 102 リアプレート
- 103 枠
- 104 アノード
- 105 画像表示装置
- 106 真空容器
- 107 低融点材料
- 108、208、308、408 導電性部材
- 109 接合部材
- 110 引出しケーブル
- 111 穴
- 150 駆動装置
- 160 電圧印加装置
- 161 電圧印加ケーブル

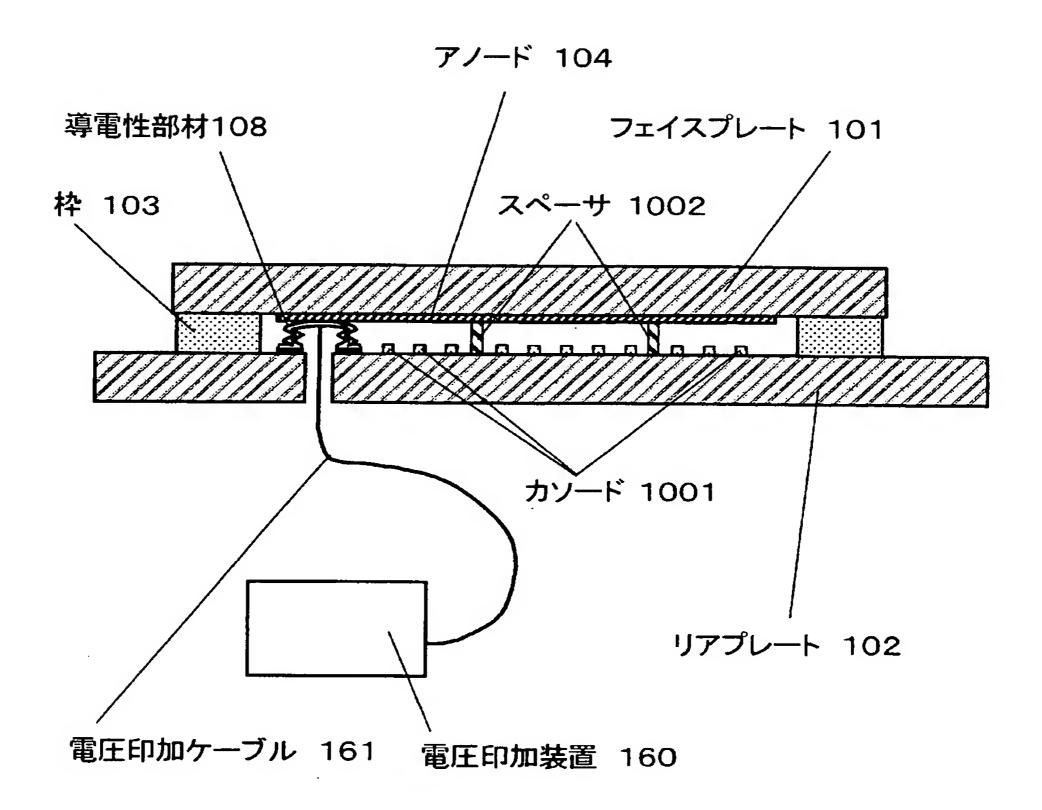
【書類名】図面【図1】

# 画像表示装置 105





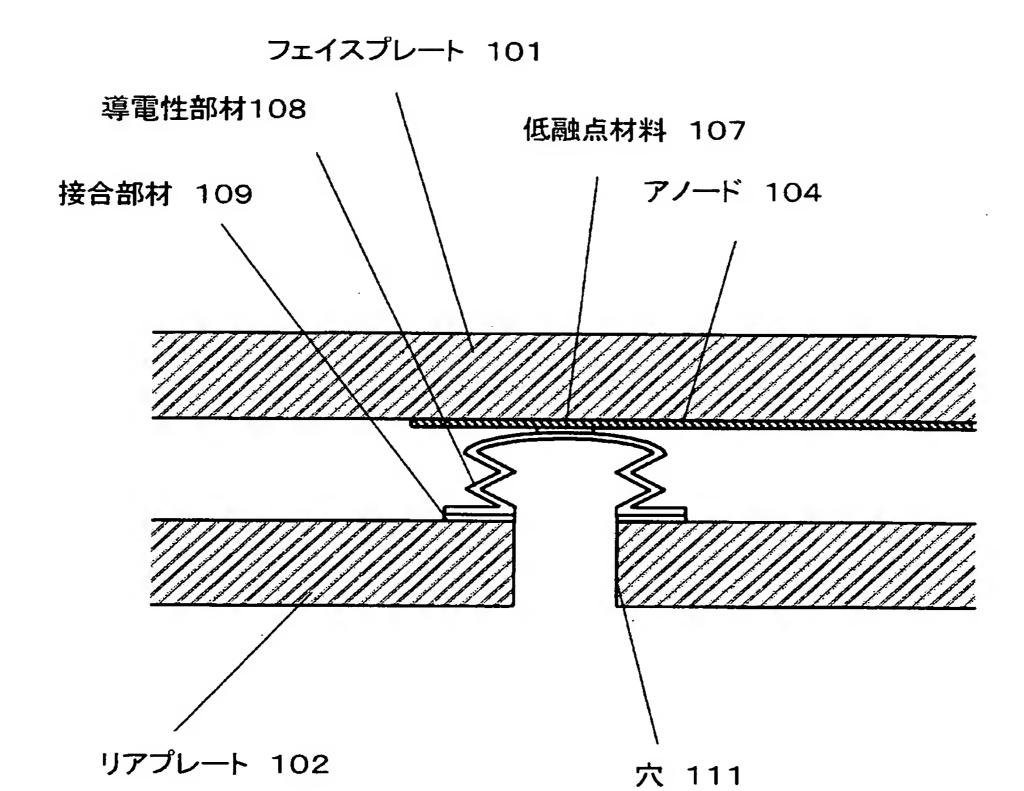
# 真空容器 106





【図3】

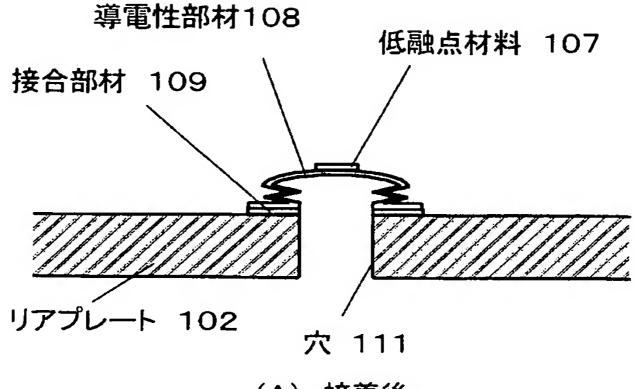
# 電圧印加構造 100



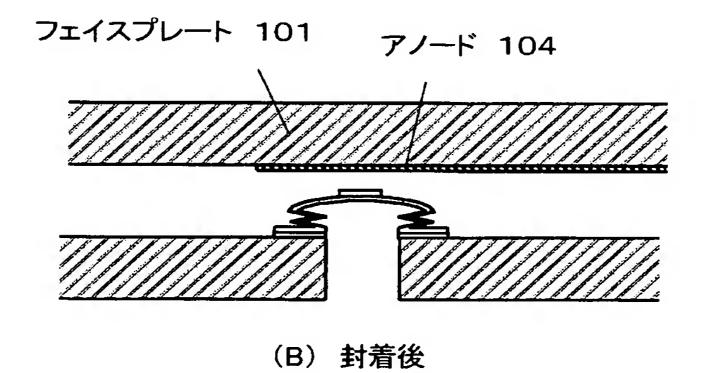
A一Aの部分断面図

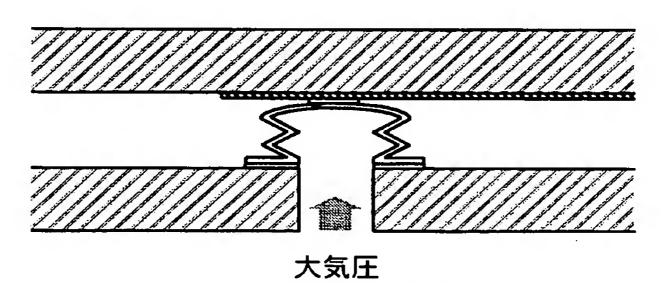


【図4】



(A) 接着後



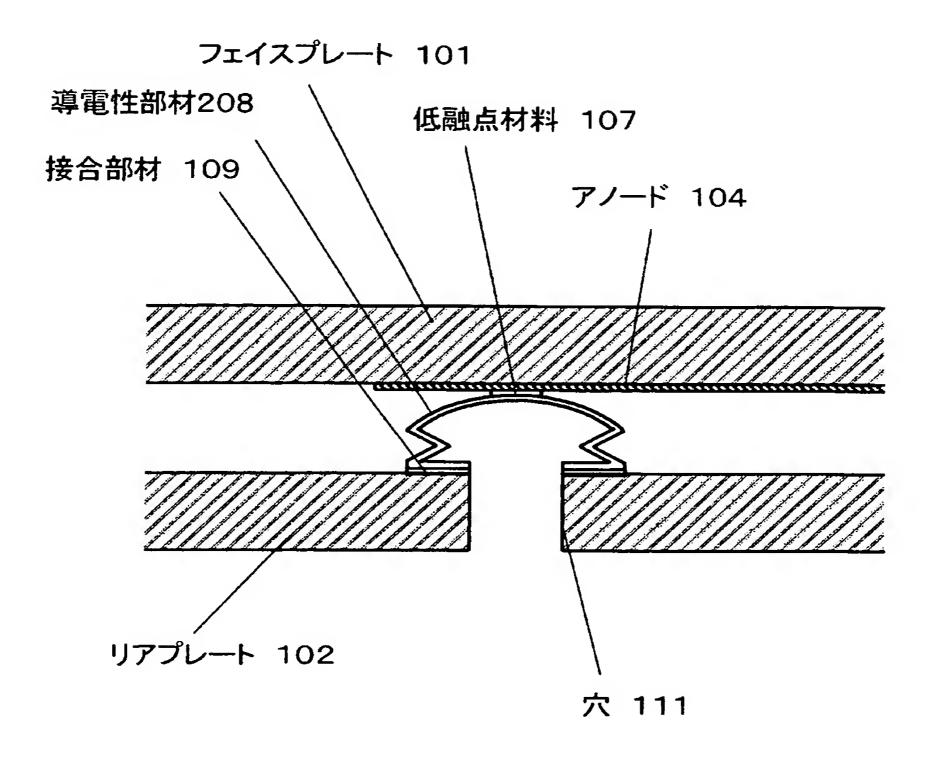


(C) 真空封止後



【図5】

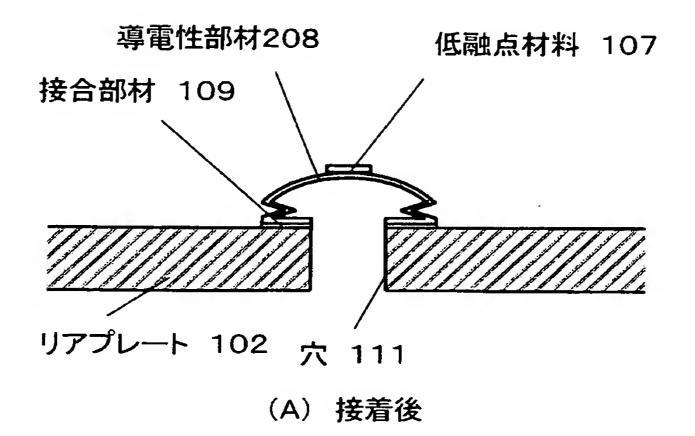
# 電圧印加構造 100

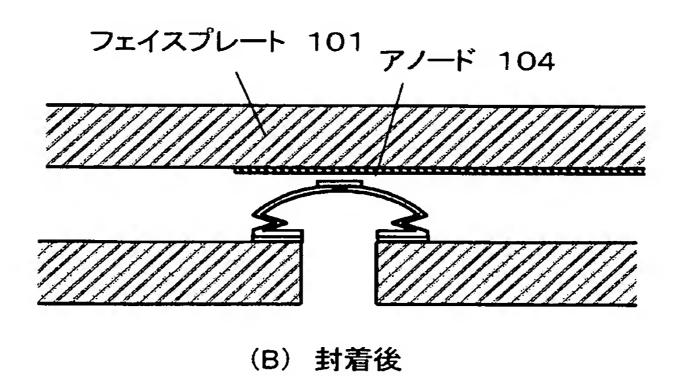


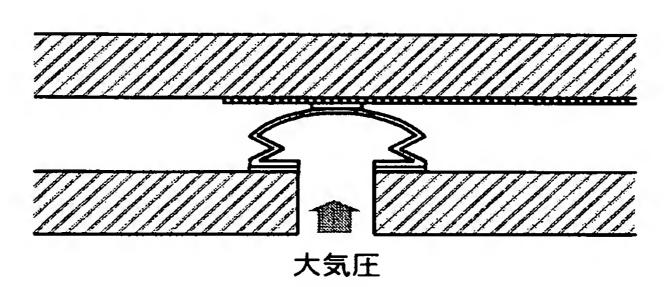
A一Aの部分断面図



【図6】



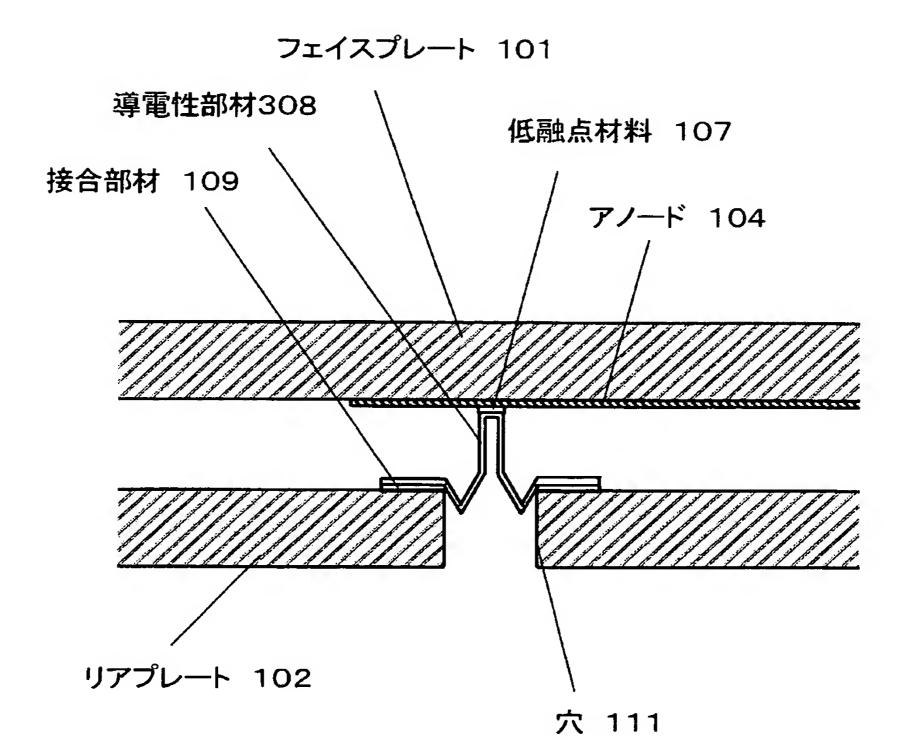




(C) 真空封止後

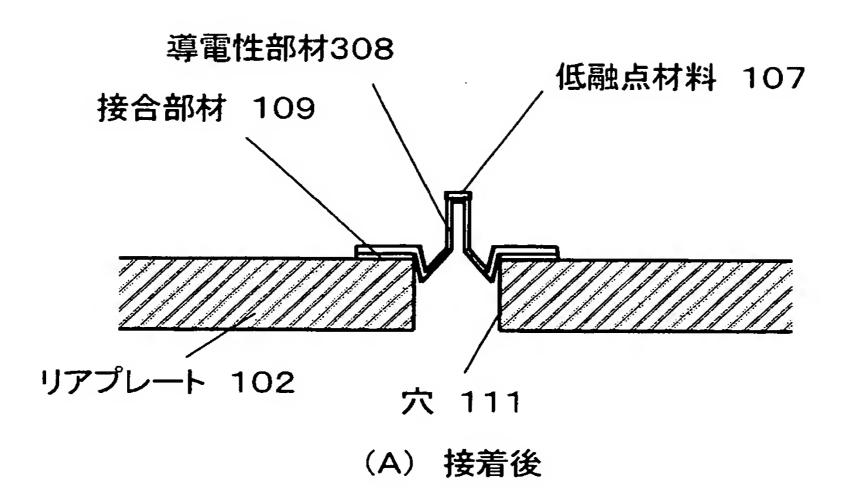
【図7】

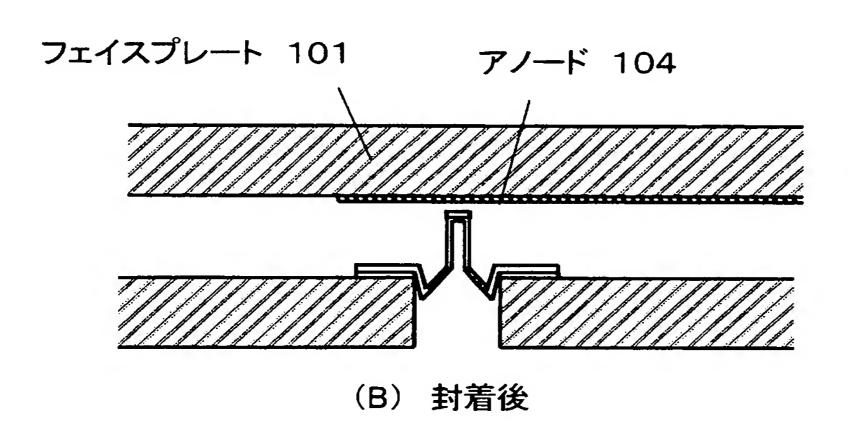
# 電圧印加構造 100

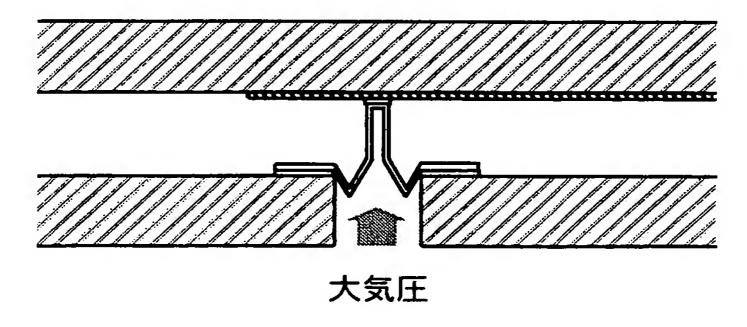


AーAの部分断面図

【図8】



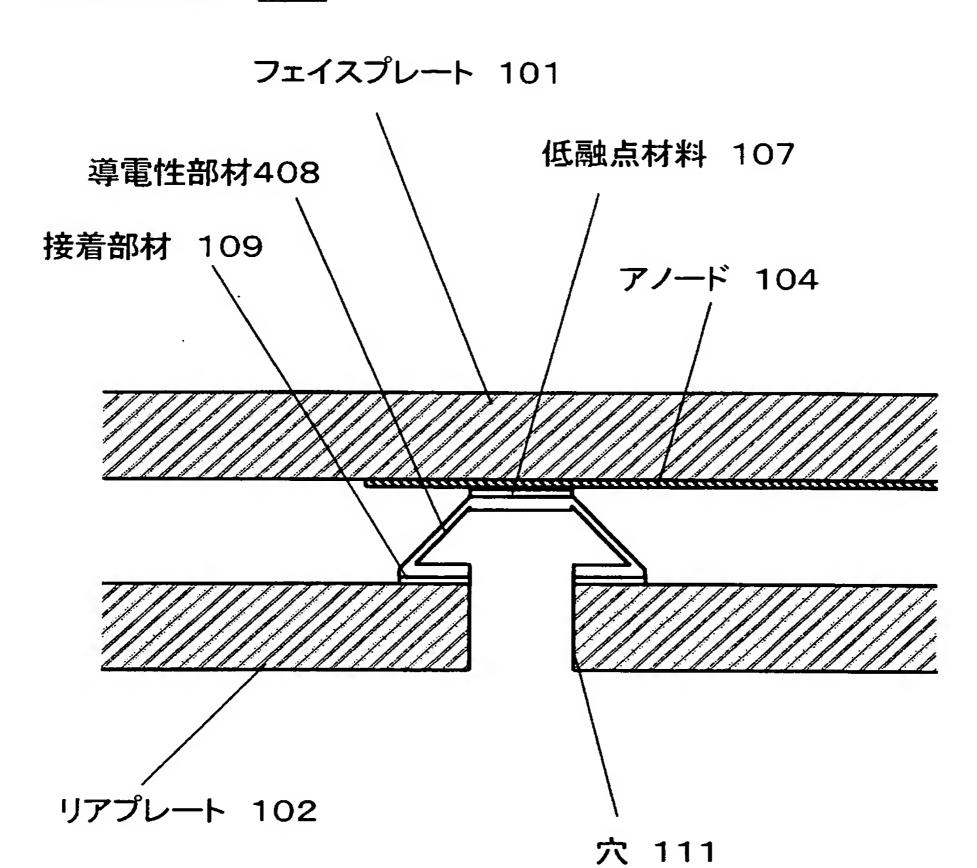




(C) 真空封止後

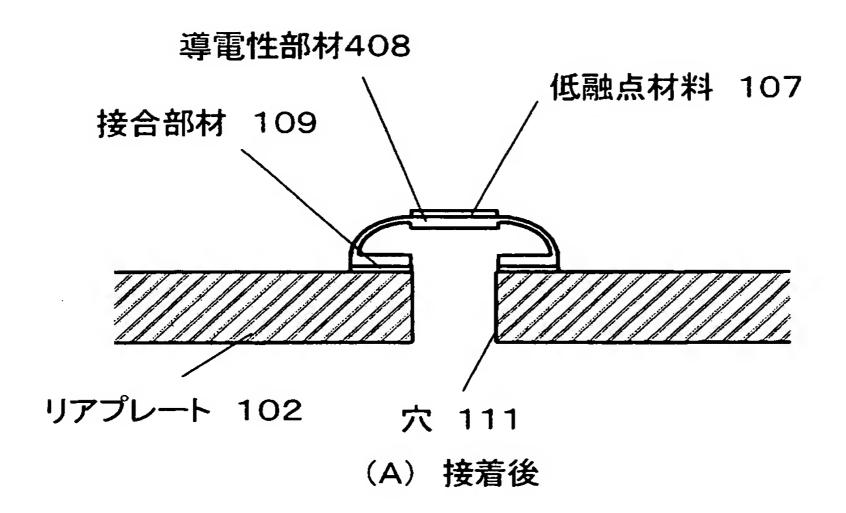
【図9】

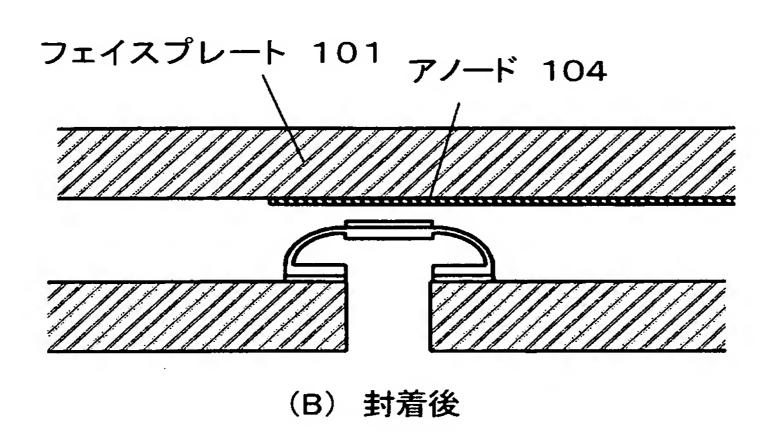
# 電圧印加構造 100

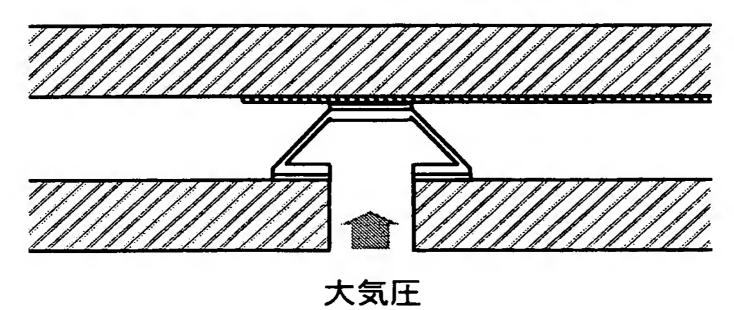


A-Aの部分断面図

【図10】

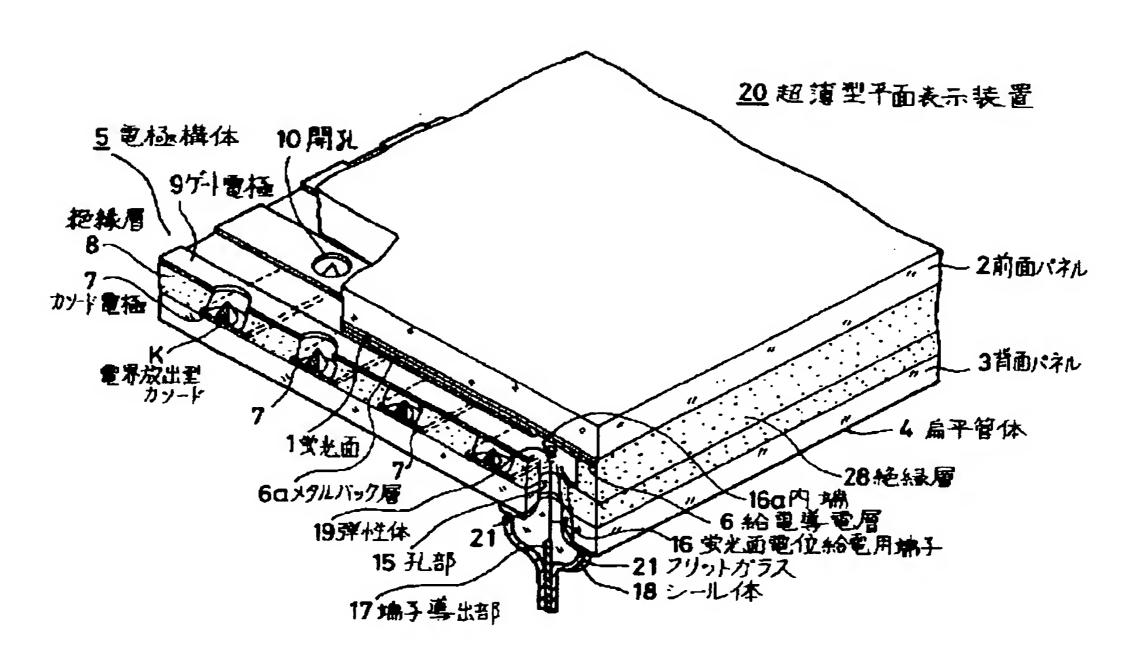






(C) 真空封止後

# 【図11】



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 ローコストに気密容器ならびに画像表示装置を実現する。

【解決手段】 互いに対向する第1の基板および第2の基板の間に外部よりも圧力の低い空間を有する気密容器の製造方法であって、第1の基板と第2の基板の間に内部空間を有する容器を組み立てる組み立て工程と、該工程で形成された容器の内外に圧力差を与える圧力差印加工程と、を有しており、前記圧力差印加工程前の前記容器において、前記第2の基板を貫通する貫通孔部で外部雰囲気に対して開口しており且つ底部が閉じた凹部を前記構造体が有しており、前記圧力差印加工程において圧力差を与えることで前記構造体の前記第1の基板と第2の基板の対向方向の長さを伸張させて、前記構造体を該構造体を介して前記電極に電位を供給できる形状にする。

【選択図】 図2

# 認定・付加情報

特許出願の番号 特願2003-296258

受付番号 50301369484

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成15年 8月25日

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】 000001007

【住所又は居所】 東京都大田区下丸子3丁目30番2号

【氏名又は名称】 キヤノン株式会社

【代理人】 申請人

【識別番号】 100123788

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階 わかば国際特許事務所

【氏名又は名称】 宮崎 昭夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100088328

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階

【氏名又は名称】 金田 暢之

【選任した代理人】

【識別番号】 100106297

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階 若林国際特許事務所

【氏名又は名称】 伊藤 克博

【選任した代理人】

【識別番号】 100106138

【住所又は居所】 東京都港区赤坂1丁目9番20号 第16興和ビ

ル8階

【氏名又は名称】 石橋 政幸

特願2003-296258

# 出願人履歴情報

識別番号

[000001007]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都大田区下丸子3丁目30番2号

氏 名

キヤノン株式会社